

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 2 部門第 4 区分  
【発行日】令和 7 年 6 月 19 日(2025.6.19)

【公開番号】特開 2025-89526(P2025-89526A)  
【公開日】令和 7 年 6 月 12 日(2025.6.12)  
【年通号数】公開公報(特許)2025-107  
【出願番号】特願 2025-53773(P2025-53773)  
【国際特許分類】

B 4 1 J 2/01(2006.01)

10

【F I】

B 4 1 J 2/01 3 0 1

【手続補正書】

【提出日】令和 7 年 6 月 5 日(2025.6.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

吐出孔および当該吐出孔から液体を吐出させるための素子を有する吐出部材と、

前記吐出部材に電氣的に接続する第 1 配線基板と、

前記第 1 配線基板に電氣的に接続する第 2 配線基板と、

を備え、

前記第 1 配線基板は、

前記吐出部材に接続される第 1 接続部と、

前記第 2 配線基板に接続される第 2 接続部と、

前記第 1 接続部と前記第 2 接続部とを接続する配線と、

30

を有しており、

前記第 1 接続部および前記第 2 接続部は、前記第 1 配線基板の同一面上に位置する液体吐出ヘッド。

【請求項 2】

吐出孔および当該吐出孔から液体を吐出させるための素子を有する吐出部材と、

前記吐出部材に電氣的に接続する第 1 配線基板と、

前記第 1 配線基板に電氣的に接続する第 2 配線基板と、

を備え、

前記第 1 配線基板は、

前記吐出部材に接続される第 1 接続部と、

40

前記第 2 配線基板に接続される第 2 接続部と、

前記第 1 接続部と前記第 2 接続部とを接続する配線と、

を有しており、

前記第 1 接続部は、平面視したとき、前記素子と重ならない液体吐出ヘッド。

【請求項 3】

前記第 1 配線基板は、平面視したとき、前記素子と重ならない

請求項 2 に記載の液体吐出ヘッド。

【請求項 4】

前記吐出部材は、第 1 端部領域および第 2 端部領域を有しており、

50

前記素子は、平面視したとき、前記第 1 端部領域および前記第 2 端部領域の間に位置しており、

前記第 1 接続部は、前記第 1 端部領域と接続される

請求項 2 に記載の液体吐出ヘッド。

【請求項 5】

前記第 1 接続部は、複数の第 1 パッドを有しており、

前記第 2 接続部は、複数の第 2 パッドを有しており、

前記複数の第 2 パッドのうちの任意の第 2 パッド面積は、前記複数の第 1 パッドのうちの任意の第 1 パッドの面積よりも大きい

請求項 1 または 2 に記載の液体吐出ヘッド。

10

【請求項 6】

前記第 2 配線基板に搭載される電子部品をさらに備え、

前記吐出部材は、前記吐出孔を有する吐出面をさらに有しており、

前記電子部品の前記吐出面からの高さは、前記第 1 配線基板の前記吐出面からの高さよりも高い

請求項 1 または 2 に記載の液体吐出ヘッド。

【請求項 7】

前記第 2 配線基板に搭載される電子部品をさらに備え、

前記電子部品は、平面視したとき、前記第 2 配線基板および前記吐出部材の間に位置する

請求項 1 または 2 に記載の液体吐出ヘッド。

20

【請求項 8】

前記電子部品は、平面視したとき、前記第 1 配線基板に重なる

請求項 7 に記載の液体吐出ヘッド。

【請求項 9】

前記第 2 配線基板に搭載される電子部品をさらに備え、

前記電子部品は、前記第 2 配線基板の両面うち、前記第 1 配線基板と接続される面に搭載される

請求項 1 または 2 に記載の液体吐出ヘッド。

【請求項 10】

前記電子部品は、平面視したとき、前記吐出部材に重ならない

請求項 9 に記載の液体吐出ヘッド。

30

【請求項 11】

前記第 1 接続部は、複数の第 1 パッドを有しており、

前記第 2 接続部は、複数の第 2 パッドを有しており、

前記複数の第 2 パッドは、前記第 1 配線基板の前記吐出部材側の一端部から他端部に向かう第 1 方向に沿って並ぶ複数の領域に、前記第 1 方向と交差する第 2 方向において互いに隣接しないように位置する

請求項 1 または 2 に記載の液体吐出ヘッド。

【請求項 12】

前記第 1 接続部は、複数の第 1 パッドを有しており、

前記第 2 接続部は、複数の第 2 パッドを有しており、

前記配線は、前記複数の第 1 パッドと前記複数の第 2 パッドとを接続する複数の配線を有しており、

前記第 1 配線基板は、前記複数の第 1 パッドに接続される前記配線の間隔よりも前記複数の第 2 パッドに接続される前記配線の間隔が大きい

請求項 1 または 2 に記載の液体吐出ヘッド。

40

【請求項 13】

前記吐出部材の上に位置し、内部に前記吐出部材に供給される前記液体が流れる流路を有するサポート基板をさらに備える

請求項 1 または 2 に記載の液体吐出ヘッド。

50

## 【請求項 1 4】

前記第 2 配線基板に搭載される電子部品をさらに備え、  
前記吐出部材は、前記吐出孔を有する吐出面をさらに有しており、  
前記電子部品の前記吐出面からの高さは、前記サポート基板の前記吐出面からの高さよりも高い  
請求項 1 3 に記載の液体吐出ヘッド。

## 【請求項 1 5】

請求項 1 または 2 に記載の液体吐出ヘッドを備える記録装置。

10

20

30

40

50